

2019年3月期 決算説明会

2019年5月17日



内外テック株式会社
JASDAQ3374

会社概要

代表取締役社長 兼 COO 岩井田 克郎

会社概要

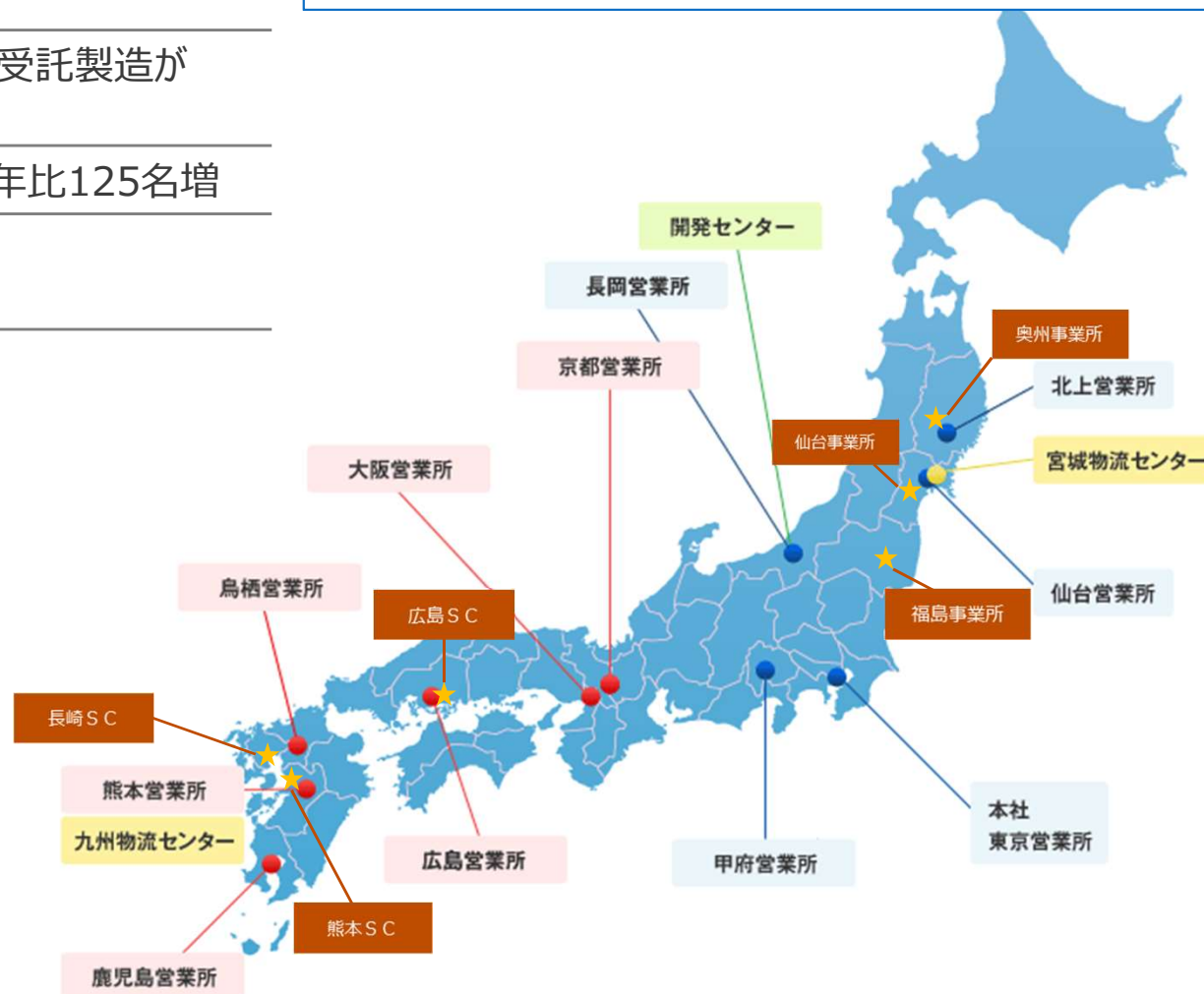
所在地	東京都世田谷区三軒茶屋
設立	1961年6月
事業内容	半導体製造装置の部品の仕入販売、受託製造が2本柱
従業員数	連結 599名（2019年3月末）：前年比125名増
連結子会社	内外エレクトロニクス 株式会社 納宜伽機材（上海）商貿有限公司

内外テックの営業所・物流センター・開発センター ○
内外エレクトロニクスの事業所・サービスセンター(SC) ★

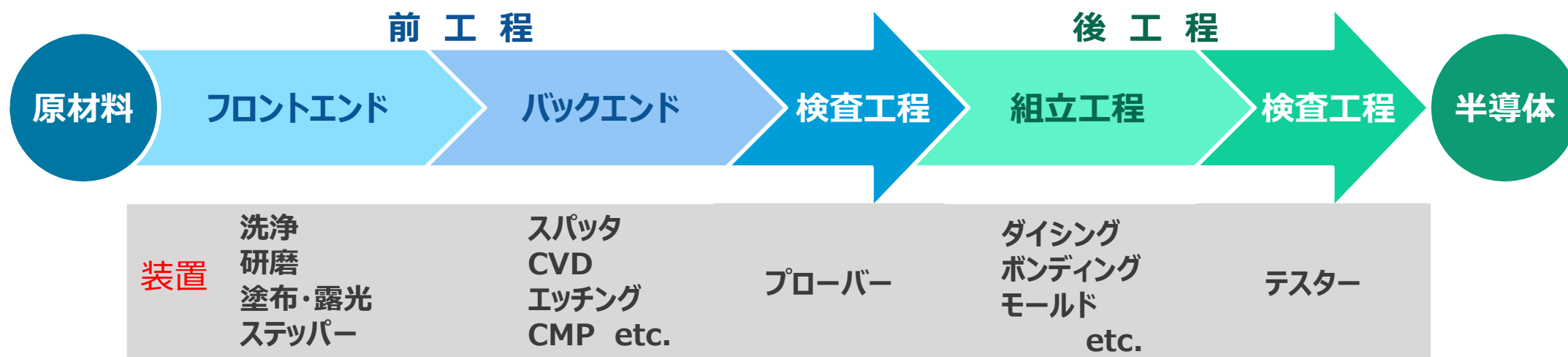
中国・上海



納宜伽機材
(上海)



半導体製造工程概要



3D NAND、メモリの調整局面があるものの、
ロジック半導体の成長により、特に前工程装置の需要が牽引

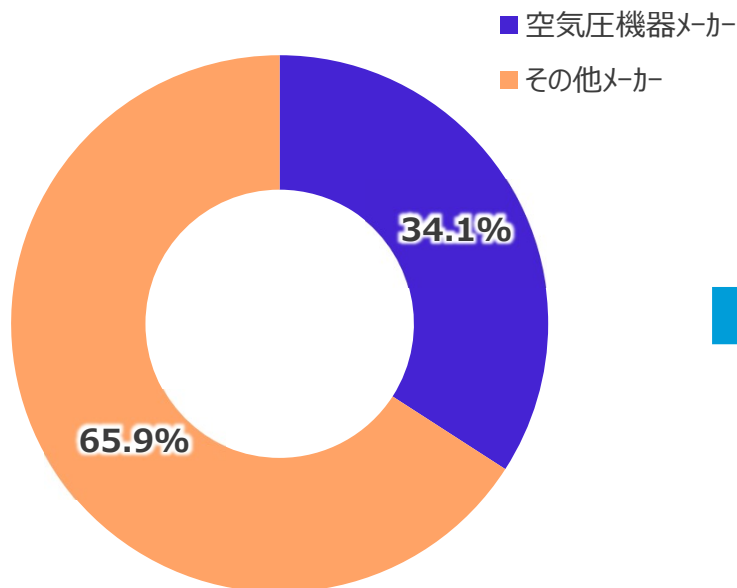
内外テック
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

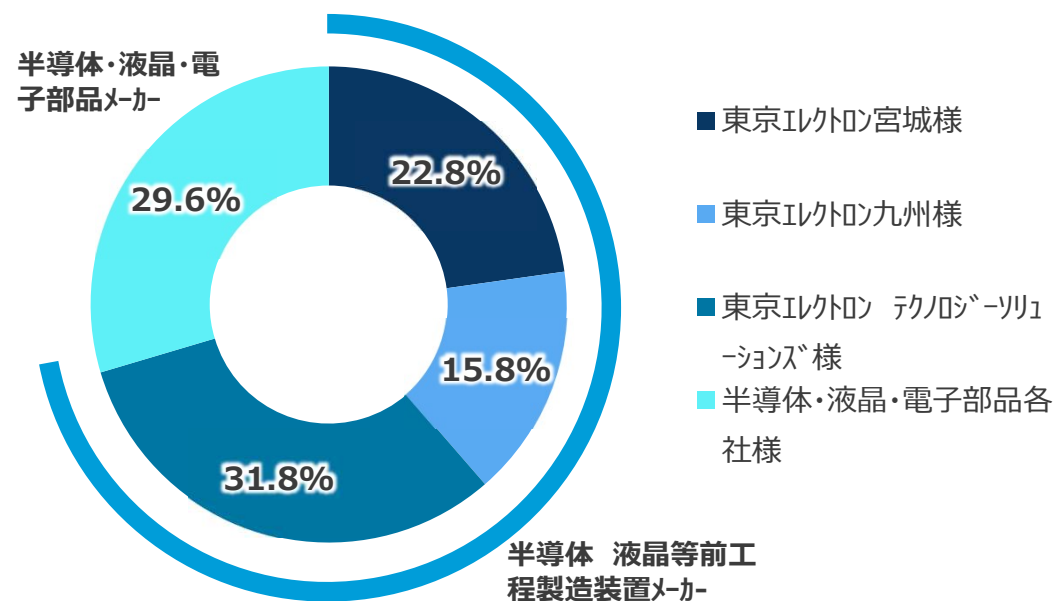
= モノづくりができるメーカー商社

【仕入先】



【販売先】

東京エレクトロングループで71.2%



内外テック 仕入先・販売先

- 仕入先メーカー数 約1600社
 - 得意先数 約 970社
 - 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造
- 年間取扱いアイテム 約66,000件

2019年3月期 実績

2019.3期 業績

■ 売上高	25,963百万円	(前期比 8.7%減)	↓
■ 営業利益	632百万円	(前期比 47.4%減)	↓

減収減益に転じる

- ⇒米中貿易摩擦、メモリの需給バランス調整から受注が期初計画に対して大幅下方に推移
- ⇒利益面では、受託製造事業が大幅減益

トピックス

■ 受託製造事業への投資が、2019年3月期にて完了

- ⇒仙台事業所 第3工場 (2018年10月竣工)
- ⇒福島事業所 増築棟 (2019年 2月竣工)
- ⇒熊本サービスセンター (2019年 2月竣工)

2020.3期 業績予想

■ 売上高	21,900百万円	(前期比 15.6%減)	↓
■ 営業利益	475百万円	(前期比 24.8%減)	↓

☞ 2期連続の減収減益見込み

- ⇒前期後半からの低迷を受けるも、メモリ回復、5Gなど新技術による半導体需要を背景に、下期より再び成長軌道への回帰を見込む

下期の需要急減が大きく影響し、減収減益

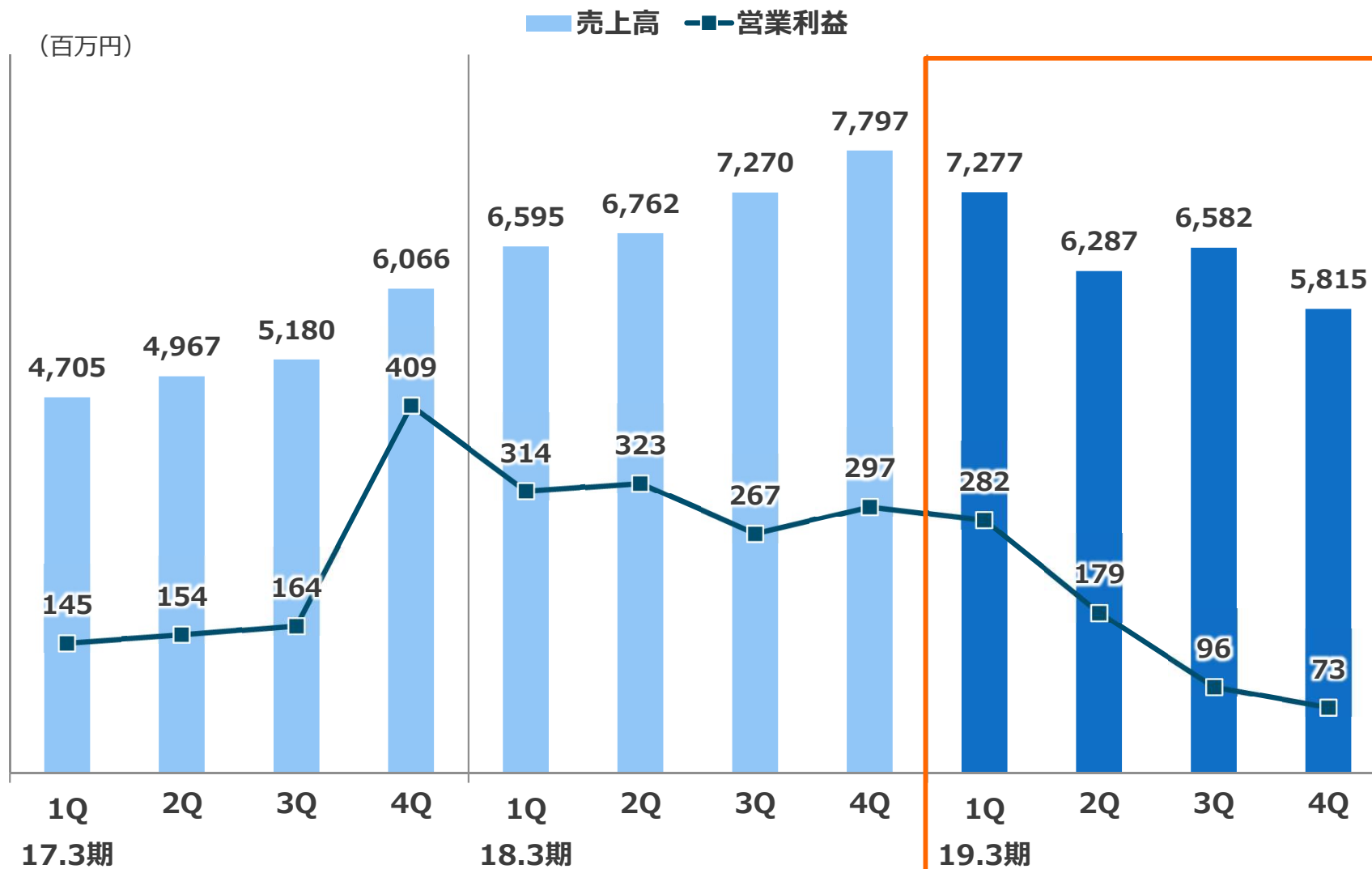
(百万円、%)

	2018.3期			2019.3期		
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比
売上高	28,426	35.9	100.0	25,963	△ 8.7	100.0
売上原価	25,190	37.2	88.6	23,146	△ 8.1	89.2
販管費	2,033	21.1	7.2	2,184	7.4	8.4
営業利益	1,202	37.6	4.2	632	△47.4	2.4
経常利益	1,184	39.5	4.2	621	△47.5	2.4
親会社株主に帰属する 当期純利益	857	36.8	3.0	409	△52.2	1.6

- 売上高は、メモリー生産調整や米中貿易摩擦による半導体需要減少を背景として減収。
- 売上高の減少、先行投資に係る販管費の増加から、営業利益は大幅に減少。
- 経常利益は、借入金の返済により金利負担が減少したものの、営業利益の減少により減益。

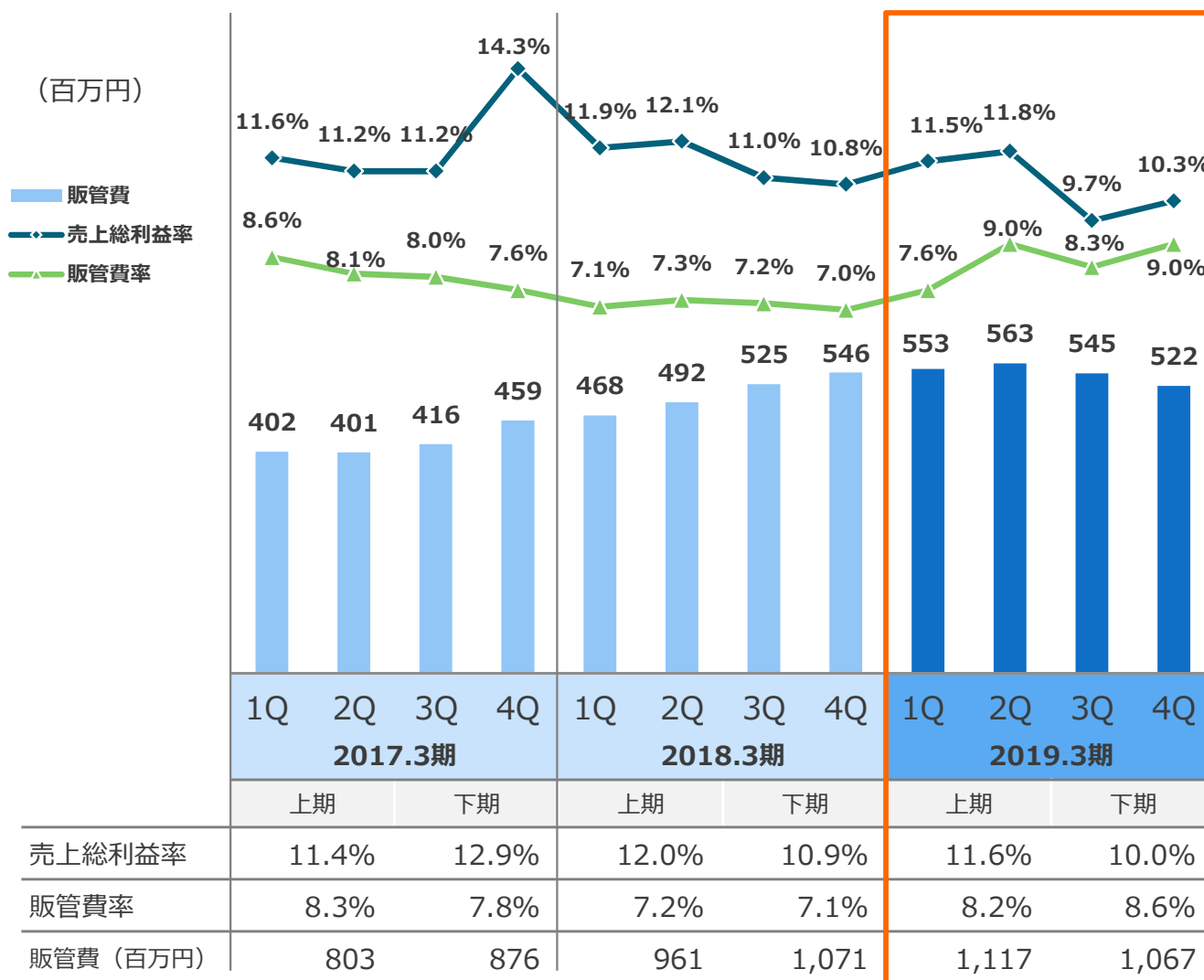
売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

売上高は、メモリーの需給バランス調整や米中貿易摩擦等から2Q以降
大幅な減収
営業利益は減収に加え、販管費増加から大幅に減少



売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、3Qで悪化したのが回復傾向 先行投資により販管費は増加



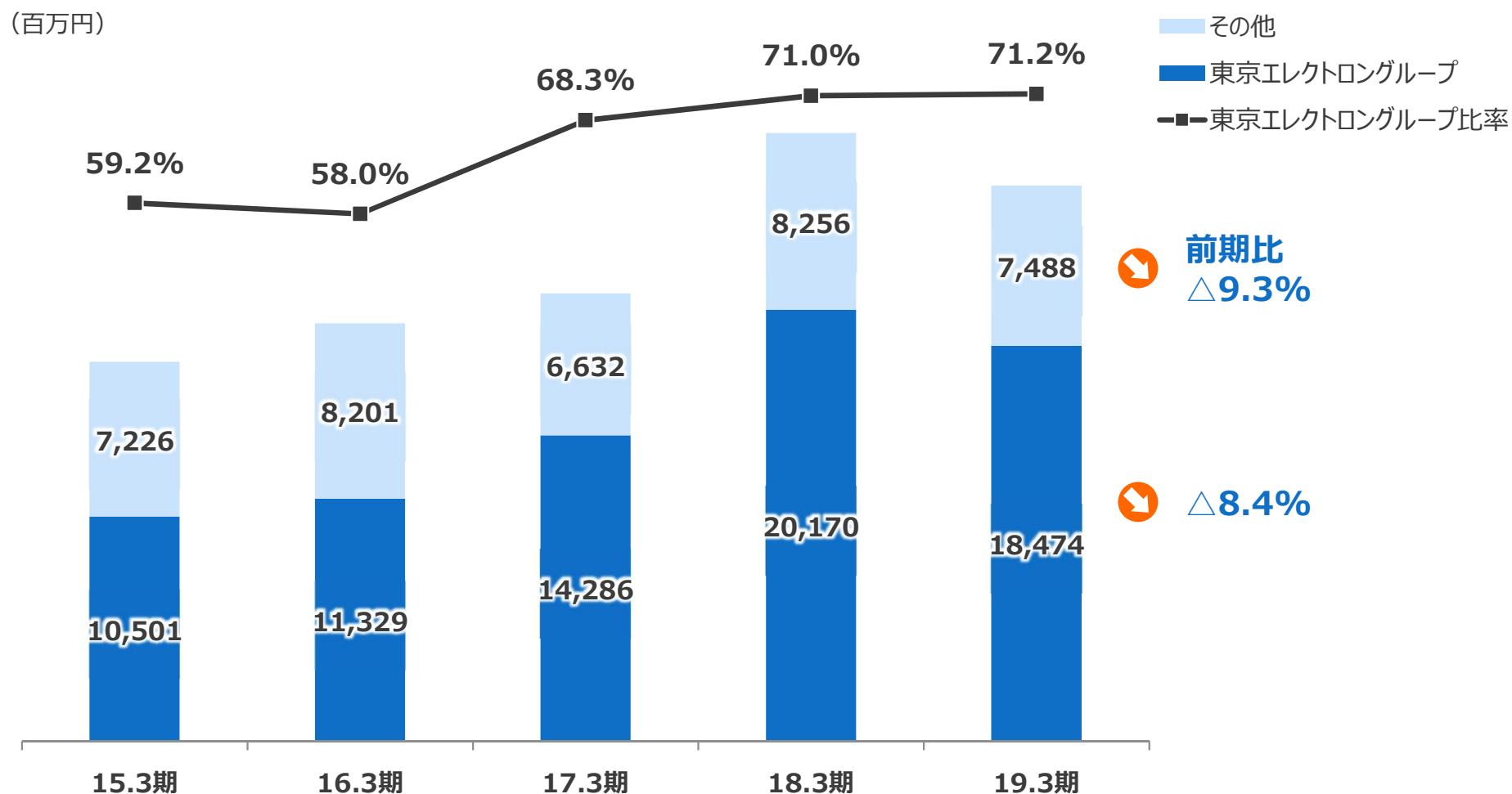
売上総利益率

- 3Qは売上減少により、労務費を中心とした固定費率が増加したことにより、売上総利益率は低下

販管費

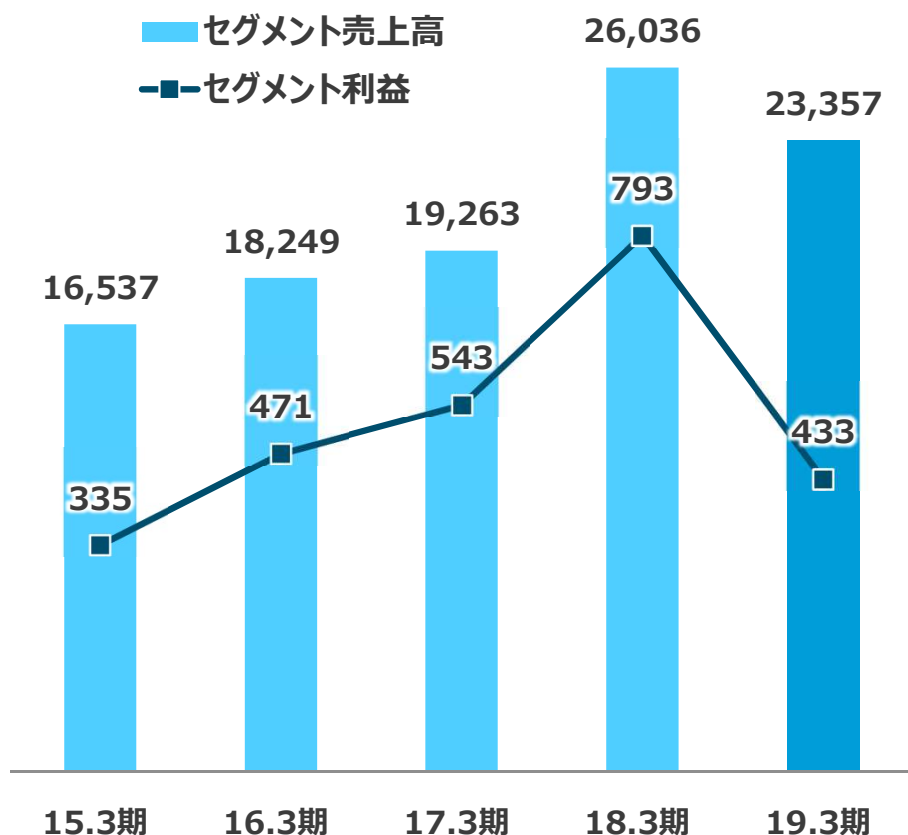
- 中長期的な半導体需要拡大を見据えた積極的な人材採用により販管費増加
- 売上減少により販管費率は上昇

東京エレクトロングループ、半導体・電子部品メーカーともに減収 高い水準で東京エレクトロングループ比率維持



米中貿易摩擦、メモリー生産調整による設備投資抑制を背景に 売上高10%減、利益45%減

(百万円)



セグメント売上高 前期比 ▲10.3% 

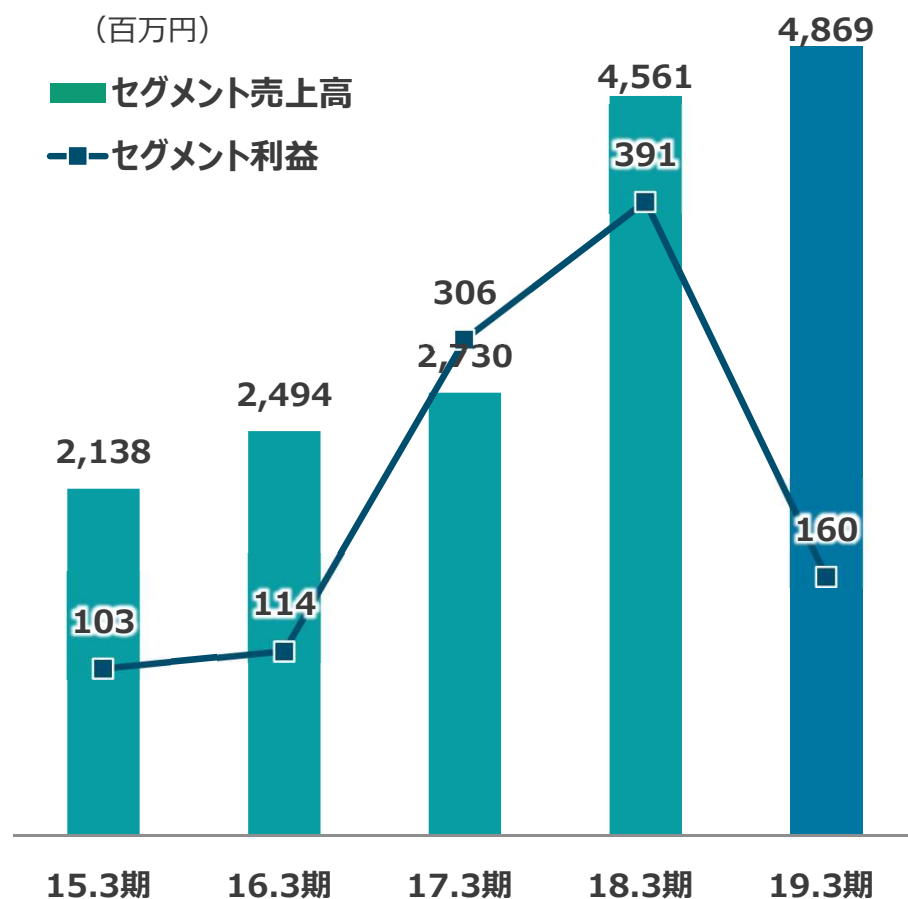
- 米中貿易摩擦による中国景気減退、メモリー生産調整による販売先の一時的な生産調整から減少
- 技術営業員のほか、一般営業員を増員し営業力を強化
- サプライチェーンのバリュー（価値）の強化
- 明確な商品戦略に基づく差別化商材の拡大


セグメント利益 前期比 ▲45.4% 

- 売上高減少に伴う売上総利益の減少
- 先行投資に係る販管費の増加によりセグメント利益は大幅減少
- 技術営業員を含む営業力強化のため人員増加
- ERPシステム変更に伴う減価償却費の増加

(注) セグメント売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ数値となっています。
セグメント利益は、四半期連結損益計算書計上額との調整額前の数値となっています。

期初計画は大幅に下回るものの受託製造能力の拡大により、売上高増 利益は、売上高の減少と中期的な増産体制対応により大幅減少



セグメント売上高 前期比 **6.8%** 

- 投資により受託製造能力を拡大
- 仙台第3工場竣工、福島事業所の生産スペース拡大、熊本サービスセンター竣工等により主要顧客の生産増への対応準備完了
- 製造・開発に係る業務提携契約締結により受注拡大、開発体制を強化

セグメント利益 前期比 **▲59.0%** 

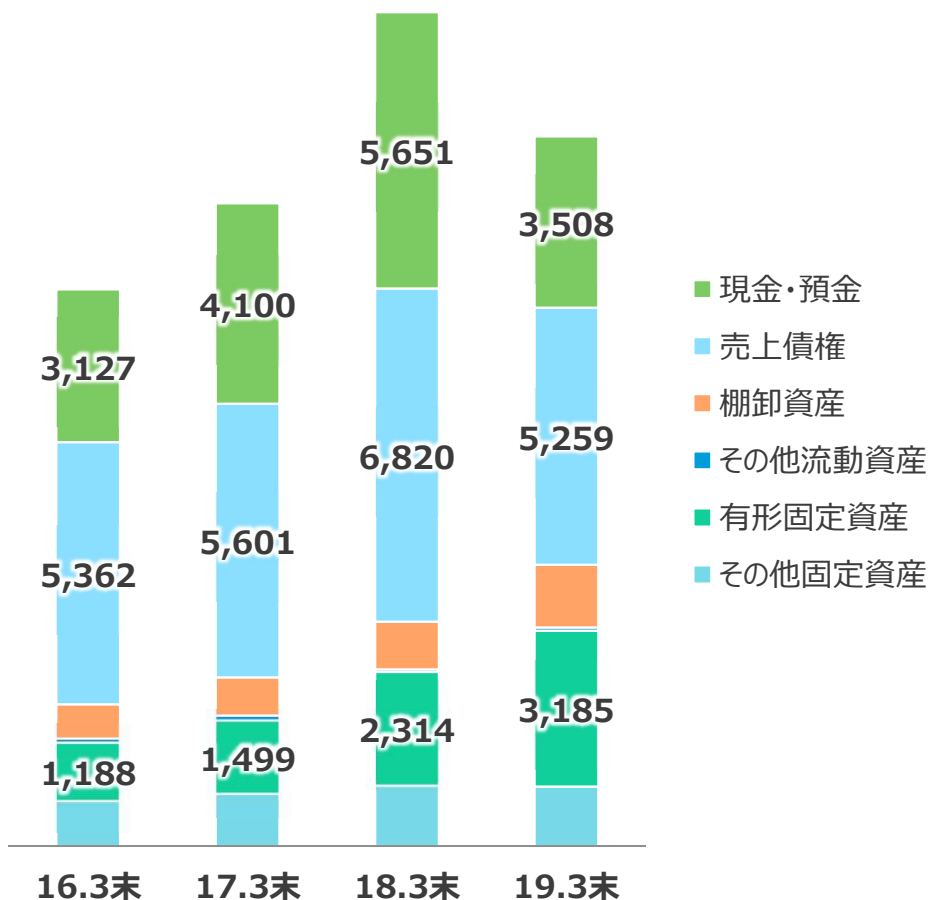
- 増産体制構築の中、販売先の一時的な生産調整によりセグメント利益は大幅な減少
- 生産性向上及び品質安定化のため、製造要員の直接雇用により製造原価が増加

(注) セグメント売上高は、セグメント間の内部売上高を含んだ数値となっています。
セグメント利益は、四半期連結損益計算書計上額との調整額前の数値となっています。

貸借対照表

◆ 資産

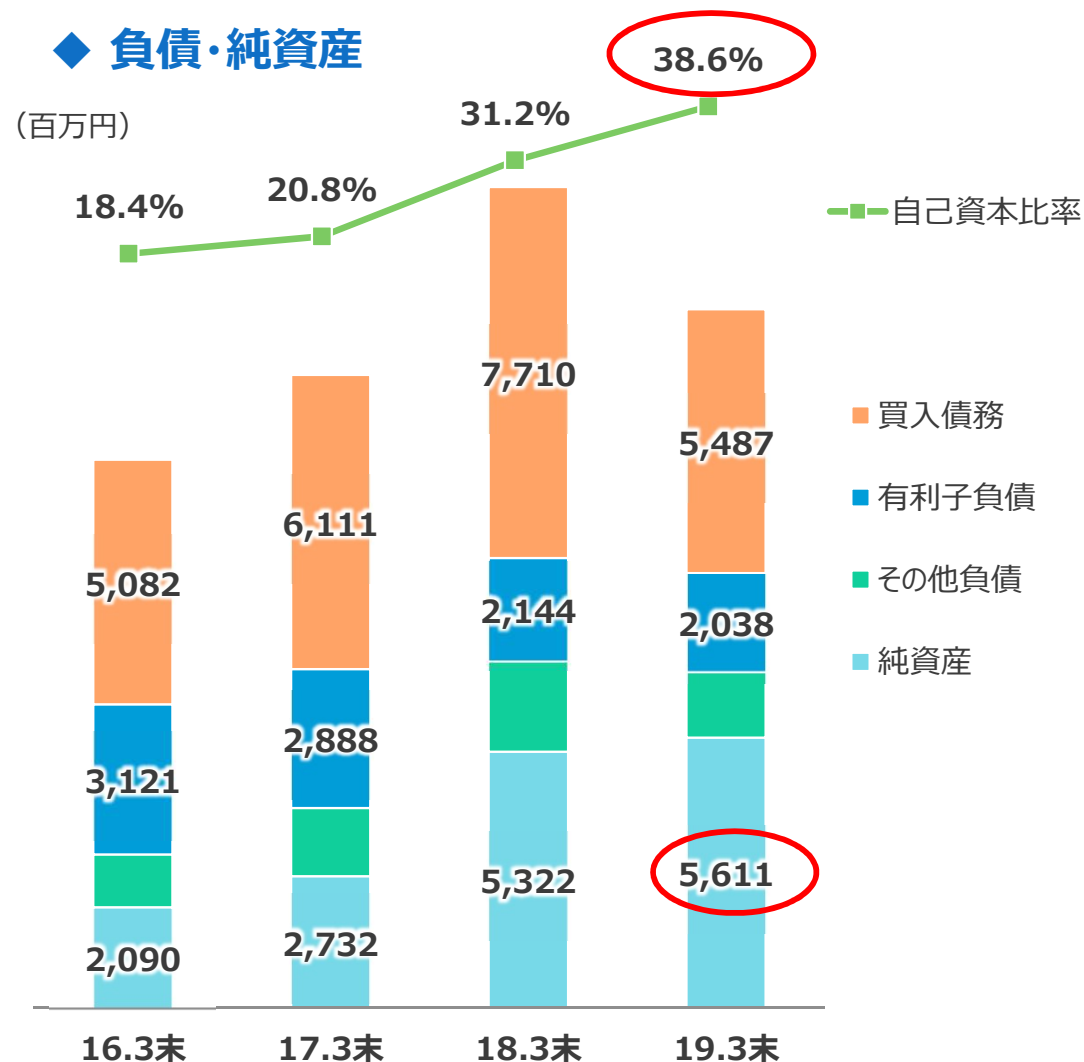
(百万円)



- 現金・預金は、受託製造事業拡大のため投資した結果、21億43百万円減少。
- 内外エレクトロニクス仙台事業所第3工場、福島事業所増築、熊本サービスセンターの投資等により有形固定資産は、8億71百万円増加。

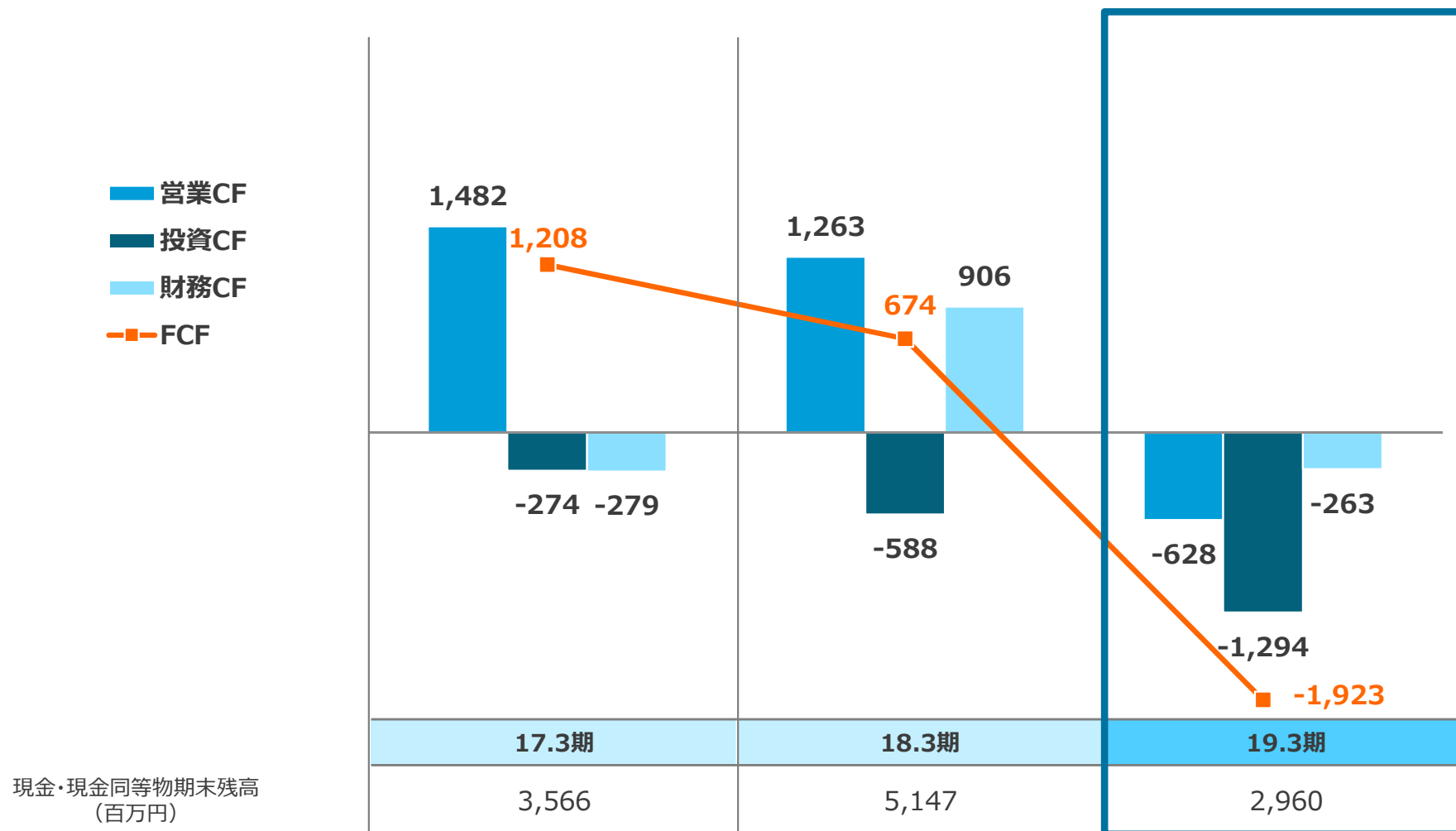
◆ 負債・純資産

(百万円)



- 利益の積み上げにより、純資産は56億円、自己資本比率は38.6%に向上
- 有利子負債は、1億6百万円減少
- 財務体質を強化

2018年3月期より引続き、増産体制に向けた設備投資強化 現金及び現金同等物残高は、29億円に

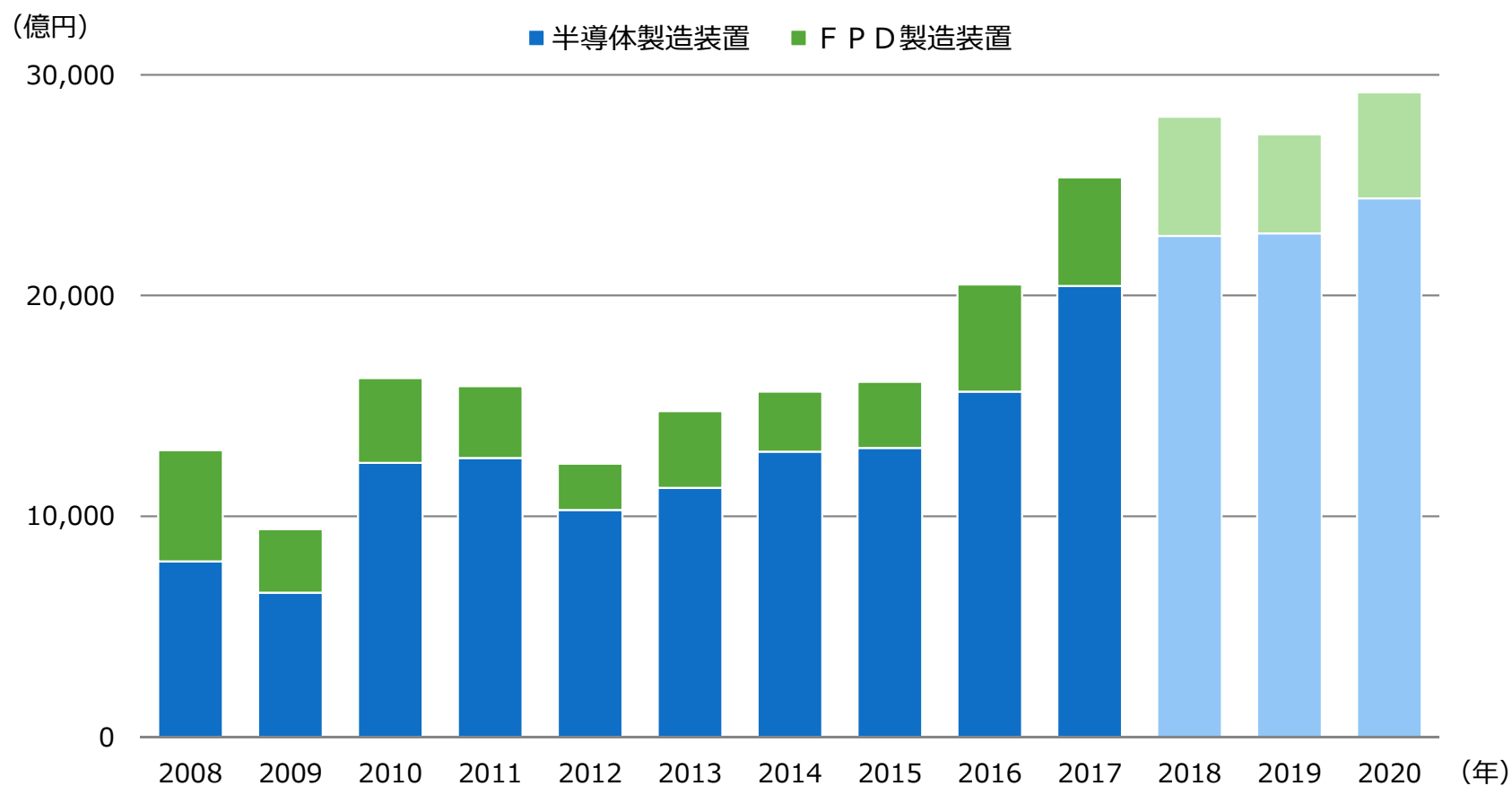


- 将来に向けた設備投資の実施により投資キャッシュフローは▲1,294百万円
- 当期純利益減少、売上債務・仕入債務のバランス、棚卸資産の増加から営業キャッシュフローは▲628百万円

2020年3月期 予想

日本製半導体製造装置販売高は、2019年に減少するも、2020年以降拡大を見込む

半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



← 予想 →

(SEAJ 2019年1月10日発表資料をもとに作成)

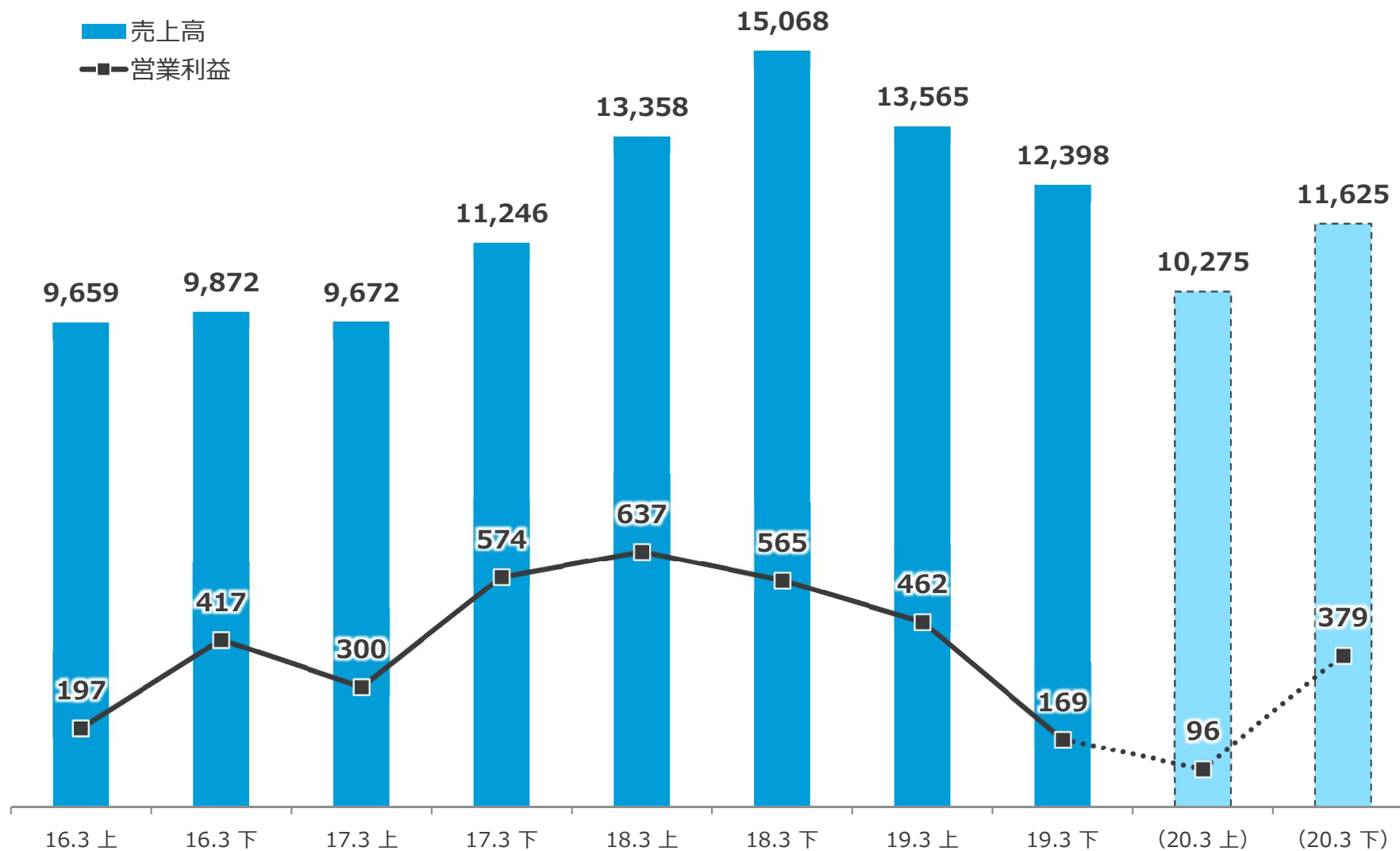
下期よりの回復を見込むも、減収減益の予想に

(百万円、%)

	2019.3期			2020.3期				
	実績	前期比	構成比	予想	前期比	構成比	2Q累計	前期比
売上高	25,963	△ 8.7	100.0	21,900	△15.6	100.0	10,275	△24.3
売上原価	23,146	△ 8.1	89.2	19,398	△16.2	88.6	9,151	△23.6
販管費	2,184	7.4	8.4	2,026	△ 7.2	9.3	1,027	△ 8.0
営業利益	632	△47.4	2.4	475	△24.8	2.2	96	△79.2
経常利益	621	△47.5	2.4	443	△28.7	2.0	80	△82.5
親会社株主に帰属する 当期純利益	409	△52.2	1.6	300	△26.8	1.4	53	△81.8

- 半導体製造装置市場は前期後半からの調整局面が続き、下期より回復を見込むが、通期では減収減益の予想
- 下期は受注回復に伴い、売上・利益ともに大幅に改善の予想

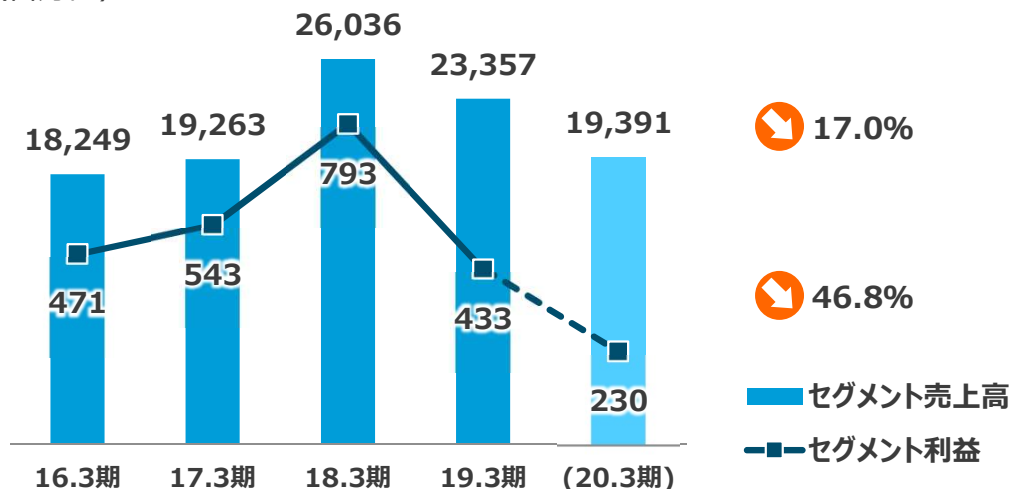
下期よりの回復を見込む



セグメント予想

◆ 販売事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 Δ 17.0% 

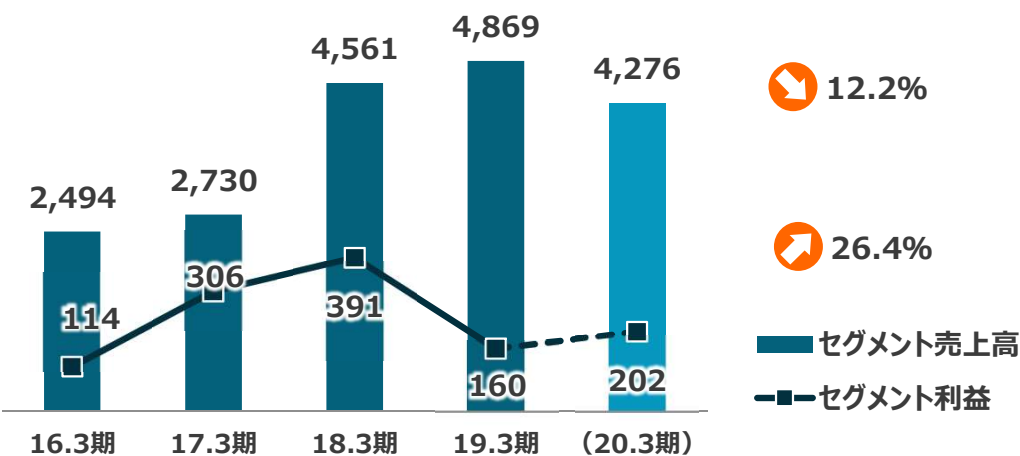
- メモリーの生産調整等から受注減少が見込まれるも、下期回復の予想。

セグメント利益 前期比 Δ 46.8% 

- 効率化による販管費の削減を進めるも、売上高の減少から前期比大幅減益を予想。

◆ 受託製造事業

(百万円)



セグメント売上高 前期比 Δ 12.2% 

- 業務提携先からの新規ビジネスによる増加を見込むも、主要顧客からの受注減少から、減少予想。
- 下期回復を見込む。

セグメント利益 前期比 26.4% 

- 間接部門の合理化を推進し製造原価の抑制により収益改善を見込む

(注) 数字は連結調整前

今後の成長に向けて

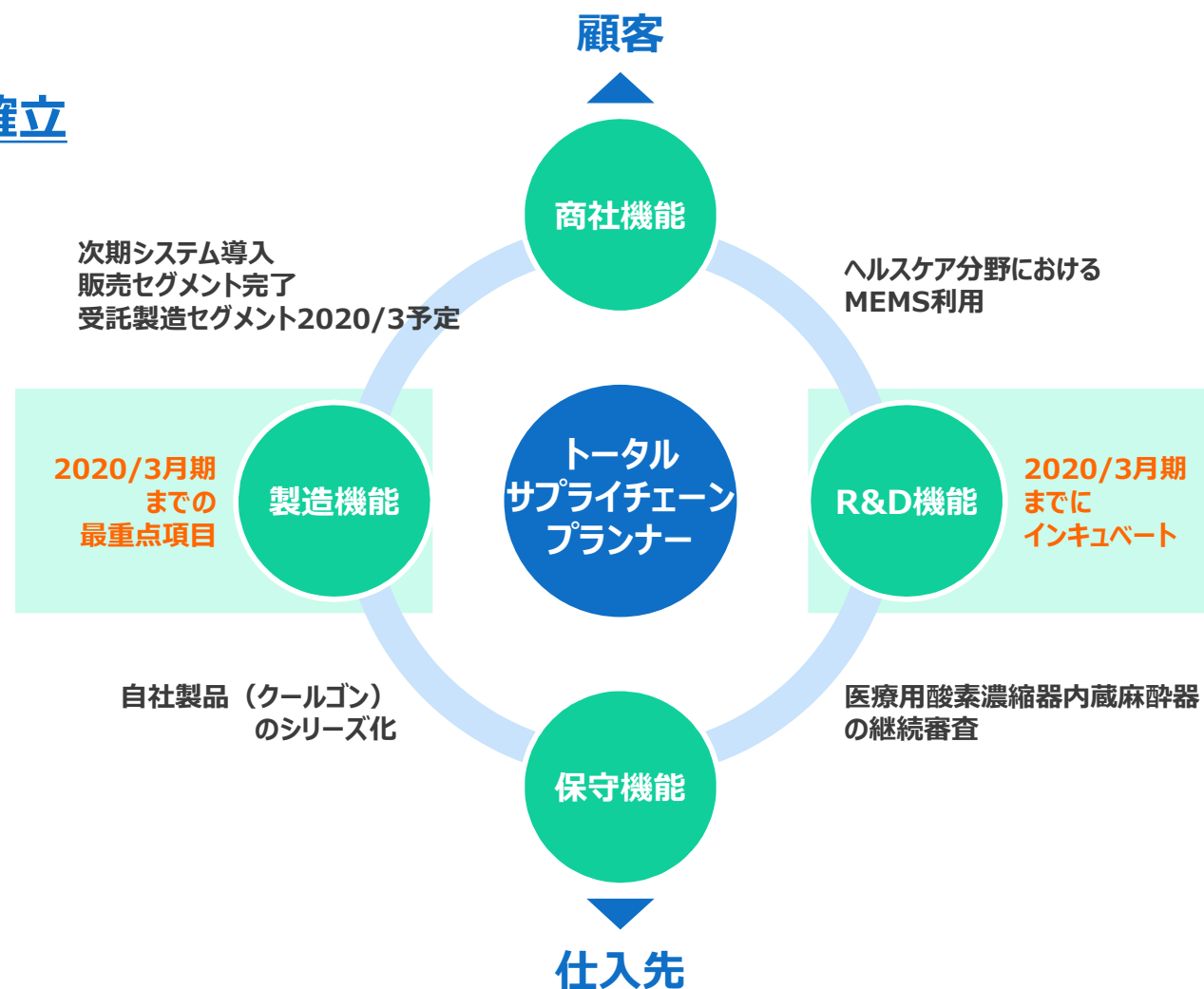
代表取締役会長 兼 CEO 権田 浩一

トータル サプライチェーン プランナー企業

サプライチェーンにおける企業価値の確立

トータル サプライチェーン プランナー企業へ 4 機能強化

- I 商社機能の強化
⇒提案型商社/技術商社
- II 製造機能の強化
⇒請負から製造メーカーへ
(開発・調達・製造一気通貫)
- III メンテナンス機能の強化
⇒選択と集中
- IV R&D機能の強化
⇒新市場への挑戦
(自社・医療機器開発)



1 受託製造セグメントの設備投資は予定通り完了

- 一時的な半導体製造装置市場の減速はあるものの、主要顧客の成長を継続的キャッチアップする方針は変わらず
- 設計、改造、組立、部品調達、スタートアップにいたる一環サービスの技術力獲得
- 協力企業から自社技術を保有するメーカーへの脱皮
- 生産合理化の一環として、ERPシステムを2020年3月までに新規導入（販売セグメントは2019年9月に導入完了）

2 収益性の高い事業への注力 / 合理化の推進

- 収益力の高い受託製造セグメントの拡大による、中期的な収益力の強化
- すべての間接部門の合理化推進（製造、営業、物流、管理）
- 販売セグメントのロジスティクスをコストセンターからバリューセンターへ変革（新物流センターの機能・立地を再検討）

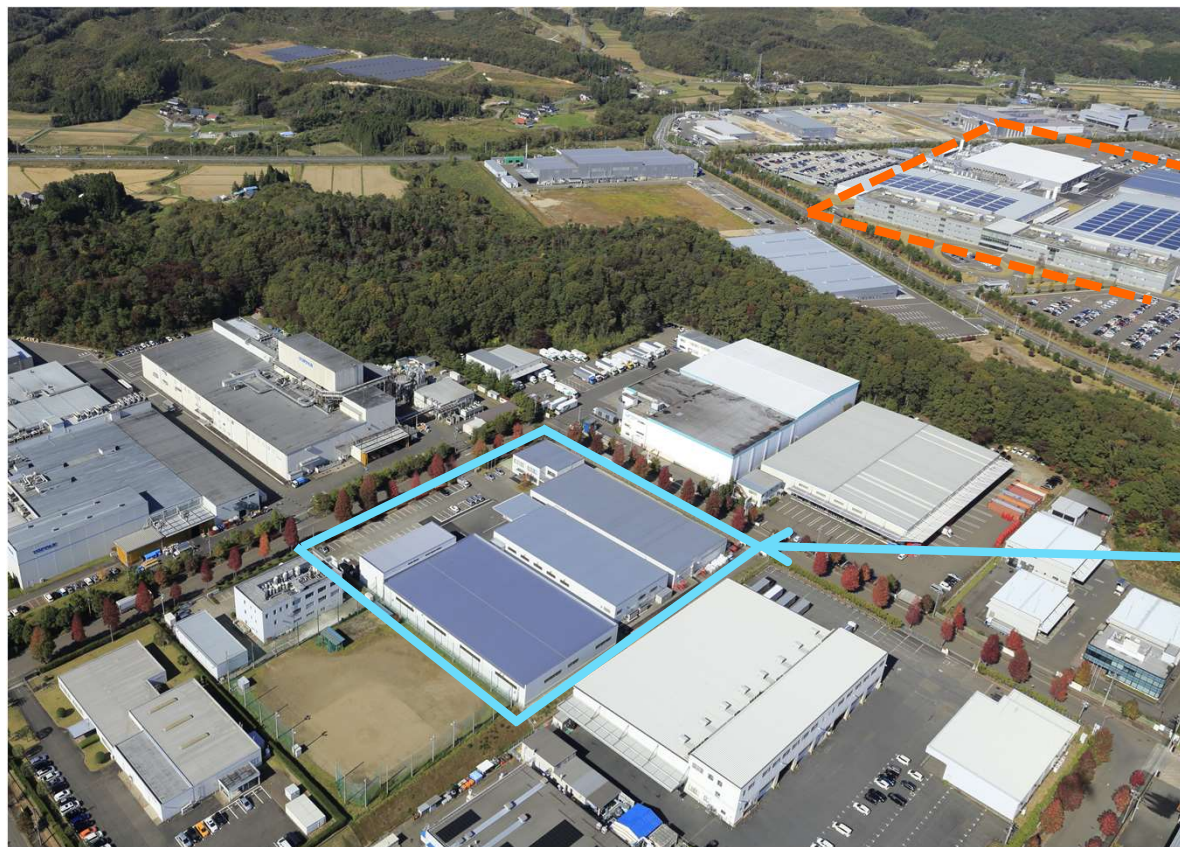
3 半導体製造装置の技術をコアに、周辺領域（FA）に市場拡大

- 半導体製造装置「エッチャー、成膜、フォトリソ、検査、洗浄」の熱、真空、空気圧、精密駆動品等のコア技術を他市場に展開
- 中期的に新たな30億程度の新市場を獲得
 - ・ 仕入先との協業による、FA分野の受託製造の領域拡大・強化
 - ・ センサーを活用したライフサイエンス事業については、2020年3月以降を目指した自社技術開発を中心としつつ、事業化のスピードアップを図るために他社との協業も視野

増産投資完了 受託製造事業の生産能力は、70~75億円に拡大

受託製造事業（子会社 内外エレクトロニクス）

仙台事業所 第3工場 2018年10月 竣工



敷地面積	13,195 m ²
延床面積	7,600 m ²
（うち第3工場	3,344 m ² ）
クリーンルーム面積	2,823 m ²

内外エレクトロニクス
仙台事業所

受託製造事業（子会社 内外エレクトロニクス）

熊本サービスセンター（NTC熊本（営））
2019年2月 竣工



敷地面積 6,104 m²
延床面積 1,143 m²

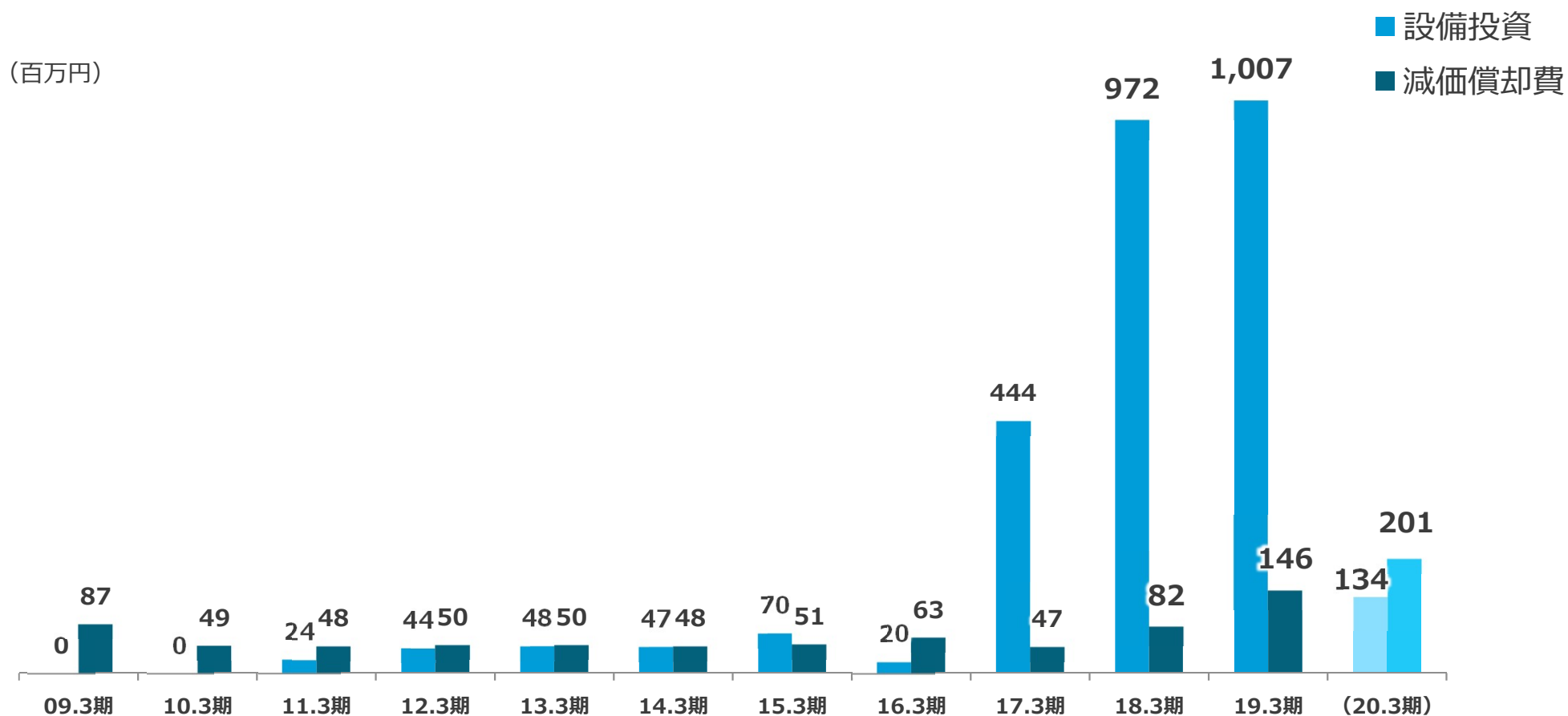
福島事業所 増築棟
2019年2月 竣工



敷地面積 26,278 m²
延床面積 5,551 m²
（うち増築棟 626 m²）
クリーンルーム面積 526 m²

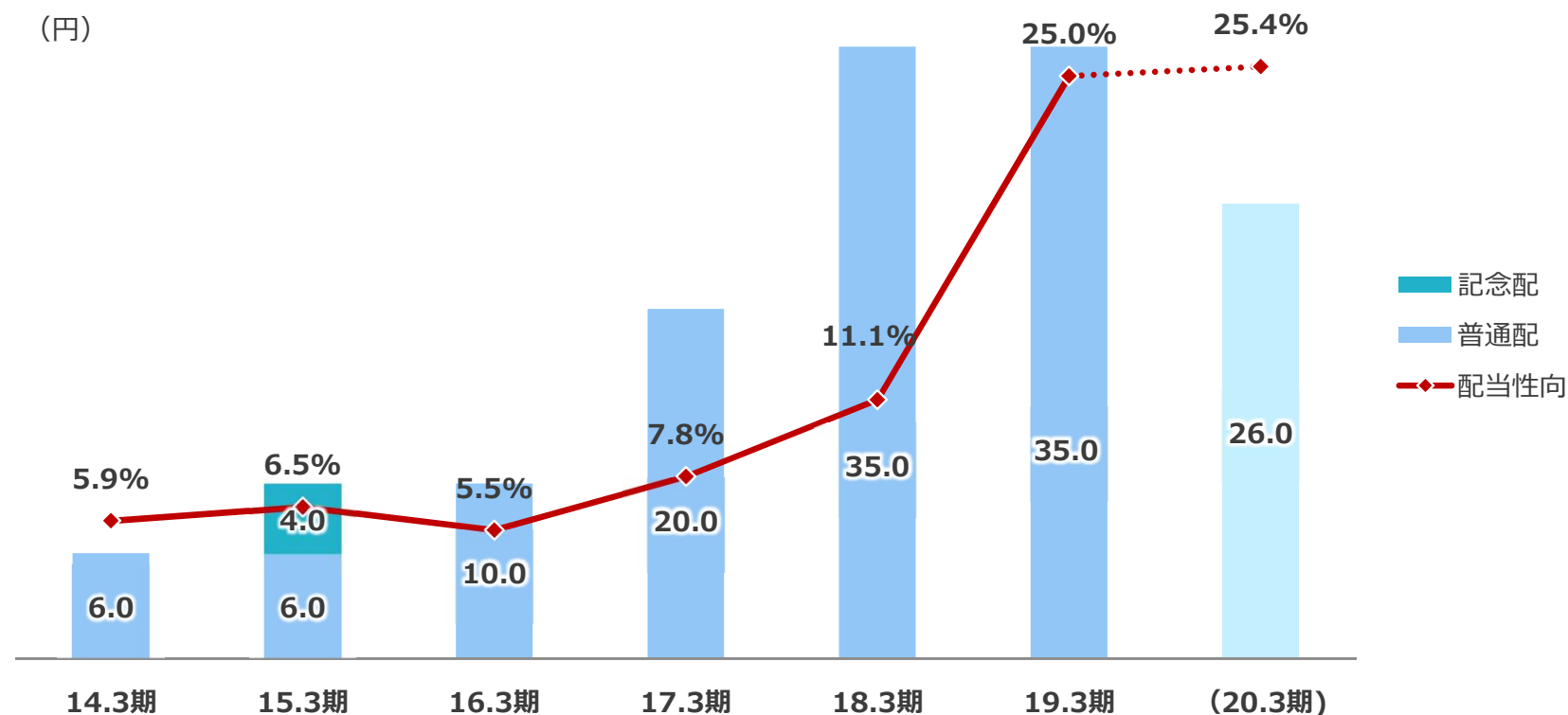
将来を見据えた受託製造の先行投資は、ほぼ一巡

- 減価償却費は2020年3月期も増加見通し



連結配当性向25%程度を基準

- 売上減少に伴う利益の減少から、2020年3月期は減配予想



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社